

Technical Data Sheet

FeedBond® EP-6000-SH5

矽膠類型固晶膠

產品特色	產品優勢
一液型	無需攪拌 (容易加工)
矽膠類型	膠不易坍塌及擴散
在光照及高溫下不易黃變	操作性佳
可作業時間長	適用製程如 pin transfer 及 dispensing 等.

產品描述:

FeedBond®EP-6000-SH5為一液型矽膠接著劑, 專用於各種光電元件如LED 之黏晶膠.

應用領域:

FeedBond®EP-6000-SH5 為 Chip LED, GaN LED chip, LED lamp bonding 等應用之黏晶膠, 可用於 pin transfer and dispensing等製程.

未硬化前性質		測試條件	測試方法
外觀	半透明		目視
黏度 @ 25°C	10000±2000 cps	Brookfield DV-III/CP-51 @ 5rpm	FT-P006
搖變指數 @ 25°C	2.0±0.5	Brookfield DV-III/CP-51 Visc. @ 0.5rpm/Visc. @ 5rpm	FT-P008
細度	< 10µm	Grind meter	FT-P026
操作時間@ 25°C	48hrs	黏度增加 25%@ 5rpm	FT-P024
保存時間@ 0~10°C	6months		FT-P018
硬化條件		測試條件	測試方法
標準硬化條件		120 分鐘 @150°C (烘箱烘烤)	

FeedBond® EP-6000-SH5

物理及化學性質		測試條件	測試方法
硬度	52±5	Durometer Shore D	FT-P037
熱膨脹係數 (CTE)	213 ppm/°C	TMA 膨脹模式(25~150°C)	FT-M016
動態拉伸模數 @25°C @150°C @250°C	181 Mpa 84 Mpa 71 MPa	DMA, 試片厚度<1.6mm	FT-M019
透光率	89%	450nm /1mm thickness	FT-P038
折射率	1.415	RM40 refractometer	FT-P054
黃變指數	2.4	450nm /1mm thickness	FT-P043
硬化後機械性質		測試條件	測試方法
Die Shear Strength @ 25°C	1.4 Kg/die	晶片尺寸 45mil × 45mil (銀支架)	FT-M012
Die Shear Strength @160°C	900g/die	晶片尺寸 45mil × 45mil (銀支架)	FT-M012
Die Shear Strength @ 260°C	700g/die	晶片尺寸 45mil × 45mil (銀支架)	FT-M012

使用指導方針

白金觸媒會與某些化合物形成錯體，阻礙觸媒作用，導致硬化不良。避免下列物質：①有含N，P，S等有機化合物② Sn，Pb、Hg、Sb、Bi、As等重金屬的離子(ion)性化合物③含有乙炔基(acetylene)等不飽和基的有機化合物

運輸

運送過程皆放入低溫冰袋低溫保存以確保產品品質。當您收到貨品時發現冰袋已回復室溫，請立即拍照存證勿使用並立刻通知我司營業人員。

回溫解凍

回溫時，直到完全達室溫時才能使用，請擦乾解凍時凝結在包裝外的水氣；不可反覆解凍以防止異常分離現象及氣泡等之產生。

保存

當您收到貨品時，請立即以冷藏儲存，由於不同溫度下之保存將影響產品的保存期限。

儲存溫度	0~10°C	25°C
保存期限	6 個月	2 天

包裝

包裝為依照客戶需求選擇針筒或塑膠罐包裝,如需要詳細資料請聯絡Feedpool客戶服務及銷售部門.